

06.3;07;12

©1995

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЕЛЕКТИВНЫХ ГЕТЕРОСТРУКТУР GaAs-InGaAs ДЛЯ СОЗДАНИЯ ИК-ФОТОПРИЕМНИКОВ

*Ю.В.Жиляев, Л.М.Канская, В.В.Криволапчук,
А.Ю.Куликов, М.Г.Мынбаева*

Фотодетекторы (ФД) для ближней ИК-области на основе сложных A^3B^5 полупроводниковых гетероструктур обладают известными преимуществами перед гомоструктурными ФД [1]. Для арсенида галлия имеется развитая массовая эпитаксиальная технология, позволяющая изготавливать многофункциональные электронно-оптические элементы. В этой связи представляет интерес реализация сочетания достижений в получении высокосовершенных $p-n$ -переходов на основе арсенида галлия и селективно выращенных относительно узкозонных слоев твердых растворов для приятия ИК-фотоприемникам длинноволновой чувствительности.

Настоящая работа является продолжением нашей предыдущей работы по созданию и исследованию фоточувствительных структур с конфигурацией, базирующейся на сформулированном выше подходе [2]. В отличие от ФД структуры, описанной в [2], данный фотоприемник представляет собой $p-n$ -структурную из арсенида галлия, на которую определенным ниже способом нанесен фоточувствительный слой твердого раствора InGaAs. В работе [3] высказано предположение, что система InGaAs-GaAS, несмотря на рассогласование решеток, имеет ряд электрофизических и технологических преимуществ перед InGaAs-InP, используемой в качестве ИК-фотодетекторов. Технология [2] позволяет при значительном рассогласовании параметров решеток изготовить ФД структуры с высокой вольтовой чувствительностью для $\lambda = 1.06$ мкм при малом обратном смещении с низким уровнем собственных шумов при комнатной температуре.

Исходная диодная $p-n$ -структура была получена методом газофазной эпитаксии слоев GaAs на n -подложке из того же материала. Толщина верхнего p -слоя составляла около 5 мкм, а нижнего n -слоя — 15–20 мкм. Сверху насыпалась пленка SiO_2 , из которой формировалась маска в виде чередующихся полос шириной 50 мкм. Затем в

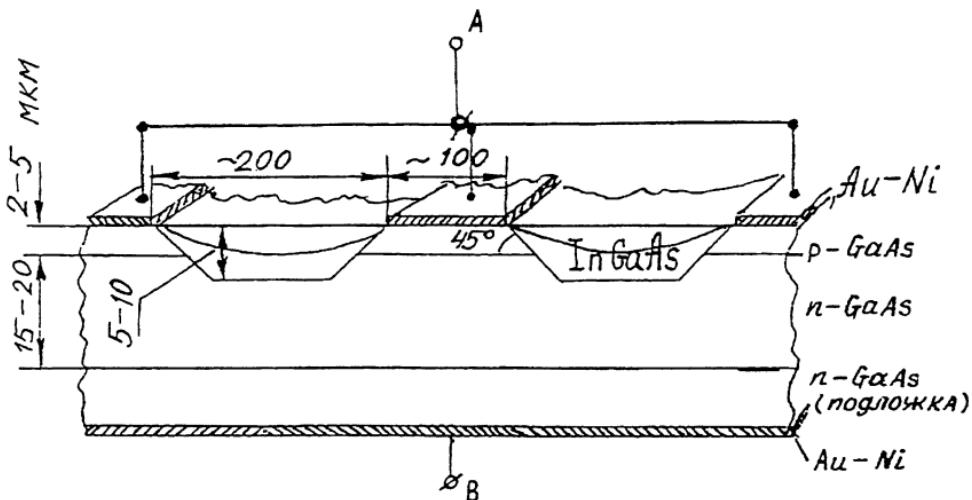


Рис. 1. Схематическое изображение элемента фотодетекторной гетероструктуры InGaAs. Сигнал снимается с выводов A-B.

окнах вытравливались канавки с углом фаски около 45° к поверхности образца на такую глубину, чтобы вскрытый в результате травления $p-n$ -переход располагался на половине общей глубины канавки. После этого профилированная поверхность GaAs методом селективной газофазной эпитаксии заращивалась нелегированным преднамеренно слоем твердого раствора InGaAs, который попадал на фаски вскрытого $p-n$ -перехода в арсениде галлия и дно канавки. Позже на поверхности образца термическим испарением с последующей фотолитографией формировались омические контакты Au-Ni к слоям p -GaAs. Второй — сплошной — омический контакт наносился на нижнюю сторону подложки. В результате была сформирована решетка фотоприемников, элемент которой схематично показан на рис. 1. Полученные таким методом структуры имели диодные вольт-амперные характеристики, ухудшенные по сравнению с исходной диодной структурой из GaAs вследствие шунтирования $p-n$ -перехода слоем InGaAs.

Измерения фоточувствительности ($\Phi\text{Ч}$) проводились при комнатной и азотной температурах в фотодиодном режиме включения при обратных смещениях в диапазоне $U = 0-8.0$ В. Последовательное сопротивление нагрузки R подбиралось по максимуму сигнала $\Phi\text{Ч}$. Спектральным прибором служил монохроматор МДР-2, а источником света — галогенная лампа накаливания.

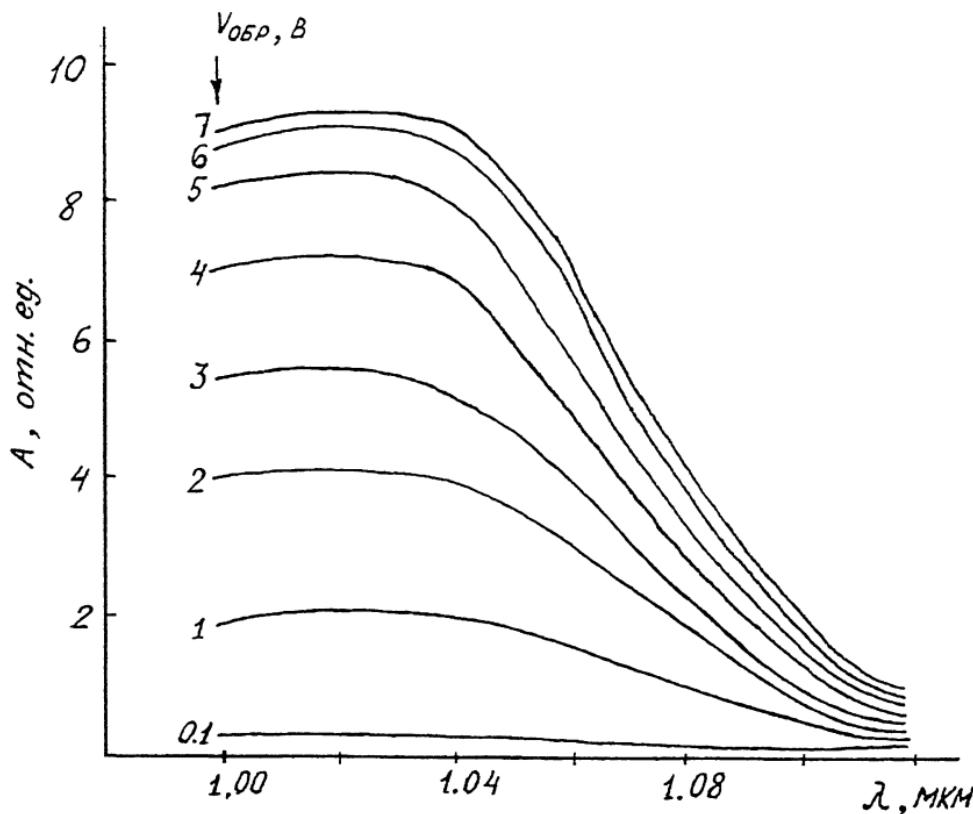


Рис. 2. Спектральные кривые фотодетекторной структуры вблизи края фоточувствительности при различных значениях обратного смещения (290 К).

Спектральные кривые исследуемых образцов в общих чертах типичны для фотопремников на гетеропереходе InGaAs-GaAs при определенном значении состава твердого раствора. Подобные спектры приводятся во многих работах последних лет, посвященных элементам оптоэлектроники, например, [3-6]. Между тем данная структура имеет и ряд существенных достоинств, которые заключаются в следующем: 1) ширина канавок с InGaAs (фоточувствительный слой), сравнима с диффузионной длиной носителей, поэтому большинство фотоэлектронов достигают гетерограницы, попадают в область пространственного заряда $p-n$ -перехода и дают вклад в фототок. Кроме того, вследствие оптимизации толщины фоточувствительного слоя выбраны условия для максимального поглощения падающего на приемник света, что также позволяет повысить квантовую эффективность прибора; 2) большое значение отношения сигнал/шум в широком температурном диапазоне.

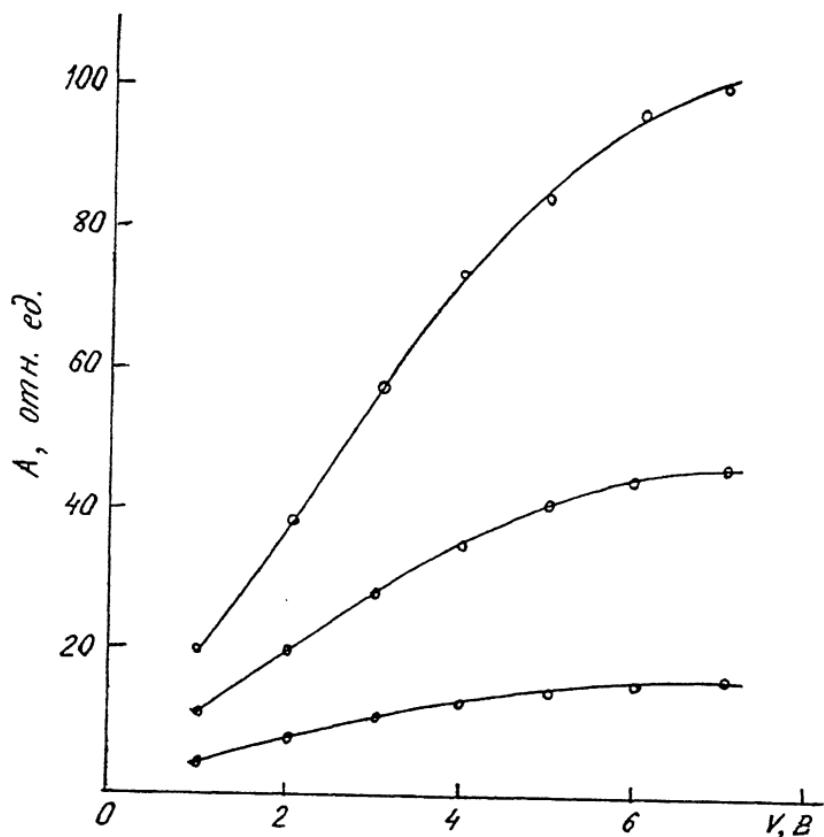


Рис. 3. Выходные характеристики фотодетектора в зависимости от напряжения U_{A-B} при различных интенсивностях освещения базовой фоточувствительной области ($\lambda = 1.04 \text{ мкм}$).

пазоне (при $T = 290 \text{ К}$ $I_{\text{темн}} < 10^{-9} \text{ А}$). При этом необходимо заметить, что незначительное обратное смещение ($U = 0.1 \text{ В}$) на $p-n$ -переходе резко усиливает фоточувствительность образца в диапазоне температур 77–300 К, а при $U = 6 \text{ В}$ сигнал ФЧ возрастает более чем в 40 раз по сравнению с тем же в отсутствие внешнего напряжения. Одновременно U понижает уровень собственных шумов фотодиода. Так, обратного смещения величиной 6 В достаточно, чтобы увеличить на два порядка отношение сигнал/шум, а следовательно, интегральную чувствительность фотодиодной структуры. Спектральная зависимость фотоответа при фиксированной интенсивности освещения от величины обратного напряжения на $p-n$ -переходе или для комнатной температуры показана на рис. 2. Как видно из рисунка, сигнал фотоответа монотонно растет с увеличением смещения, приложенного к $p-n$ -переходу, и при напряжении, приближающемся к величине обратного напряжения пробоя

диода, выходит на насыщение, причем насыщение происходит раньше пробоя. Это объясняется тем, что при данной интенсивности света все фотогорожденные носители, достигшие области пространственного заряда $p-n$ -перехода, эффективно разделяются электрическим полем и дают вклад в фототок. Благодаря усилинию, возникающему в каждом элементе приемника, отношение сигнал/шум при $T = 290$ К достаточно велико для регистрации слабых сигналов (при $T = 290$ К и частоте модуляции 480 Гц токовая чувствительность приблизительно равна 0.5 А/Вт). Усиление достигается тем, что каждый элемент прибора представляет собой аналог фототранзистора, в котором эмиттер и коллектор сформированы $p-n$ -переходом на GaAs, а базовой областью является фоточувствительный слой InGaAs. Для того чтобы лучше проиллюстрировать работу прибора, обратимся к зависимости величины фотоответа A от напряжения на $p-n$ -переходе при разных интенсивностях освещения. Эти зависимости приведены на рис. 3. При этом следует заметить, что интенсивность засветки определяет количество носителей, инжектированных в область $p-n$ -перехода. Тем самым эти кривые представляют собой не что иное, как типичное семейство статических характеристик биполярного транзистора для разных токов базы и различных значений $U_{\text{вк}}$.

Другой особенностью данной структуры является изменение сигнала ФЧ от угла падения ИК-излучения. Это свойство весьма важно для использования в системах индикации объекта (например, приборах ночного видения), так как значительно расширяет линейное поле зрения приемника. Обычно увеличение размеров чувствительной площади приемника ведет к ухудшению его характеристик. Если же фотоприемник эффективен для внеосевых лучей при малых линейных размерах — преимущества его очевидны. Это качество данной структуры в сочетании с возможностью максимизировать отношение сигнал/шум и слабой зависимостью внутреннего сопротивления от температуры делает ее перспективной также для использования в системах электронной фильтрации ИК-излучения.

Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований.

Список литературы

- [1] Криксунов Л.З. Справочник по основам инфракрасной техники. М.: Моск. радио, 1978. 400 с.
- [2] Канская Л.М., Кечек А.Г., Криволапчук В.В., Мынбаева М.Г., Поплетаев Н.К., Федоров Л.М. // Письма в ЖТФ. 1993. Т. 19. В. 16. С. 66–69.
- [3] Ng W., Narayanan A., Hayes R.R., Persechini D., Yap D. // IEEE Photon Technol. Lett. 1993. V. 5. N 5. P. 514–517.
- [4] Канская Л.М., Куликов А.Ю. // Письма в ЖТФ. 1995. Т. 21. В. 5. С. 21–25.
- [5] Rogers D.L., Woodall J.M., Pettit G.D., McInturff D. // IEEE. Trans. Electron. Devices ED-34. 1987. P. 2383–2387.
- [6] Nakajima K., Sugimoto K., Hirohata T., Mizushima Y. // Appl. Phys. Lett. V. 61. N 23. P. 2575–2576.

Физико-технический институт
им. А.Ф. Иоффе РАН
Санкт-Петербург

Поступило в Редакцию
10 июля 1995 г.
